



Satinatura / Spazzolatura

a SECCO e UMIDO per:
lamiere e coils



Sbavatura / Satinatura Universale

(arrotondamento bordi e rimozione ossido)
a SECCO e UMIDO per:
pezzi ossitagliati, tagliati al plasma,
al laser, punzonati, cesoiati



Sbavatura Universale "sotto-sopra" in un unico passaggio

(arrotondamento bordi e rimozione ossido)
a SECCO per:
pezzi ossitagliati, tagliati al plasma,
al laser, punzonati, cesoiati



Satinatura / Rettifica

ad UMIDO per:
piastre,
profili e
parti per il settore Automotive



Caratteristiche tecniche principali

banco mobile
-
testa mobile

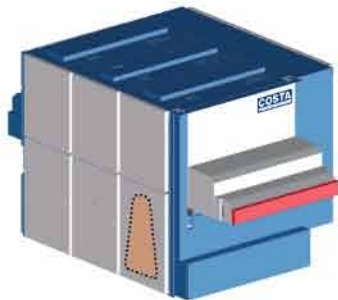


Macchina "stand-alone"



Macchina "in linea"
con altre macchine o rulliere

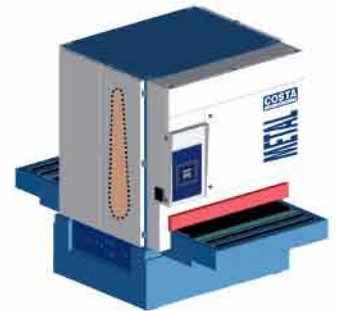
lato di lavoro:
inferiore o superiore
inferiore+superiore



Satinatrice / sbavatrice inferiore



Sbavatrice
inferiore + superiore



Satinatrice / sbavatrice superiore

lavorazione a:
secco o umido



La polvere generata dal processo di lavorazione
è aspirata da un flusso d'aria



La polvere generata dal processo di lavorazione
è portata via da un liquido refrigerante.

Sede legale: Schio

Stabilimento: Sandrigo 2

Stabilimento: Sandrigo 3

